

産学官金連携フェア2019みやぎ ビジネスマッチング展示会・商談会 技術シーズ公開シート[企業]

アピール スパッタリングターゲット材の製造、開発

ブース番号103

テーマ スパッタリングターゲット材の製造、開発

企業名 株式会社ワイドテクノ

技術シーズの概要

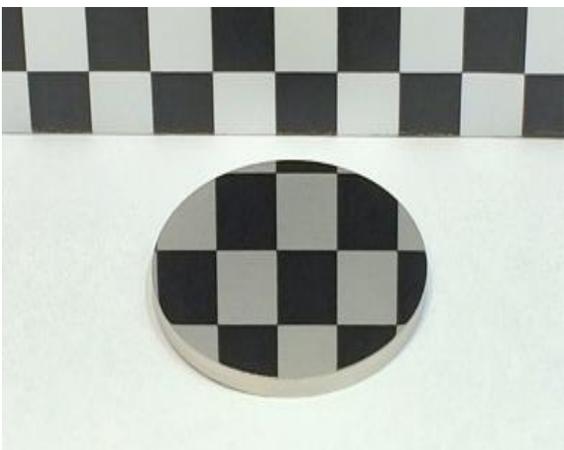
どんなシーズか？	結晶粒径の微細化、溶体化処理を行った高品質スパッタリングターゲット材の開発と薄膜の成膜テスト
想定する市場は？	半導体、電子部品等(IoT等のセンサー開発)
特許の有無	無

出展ニーズは？

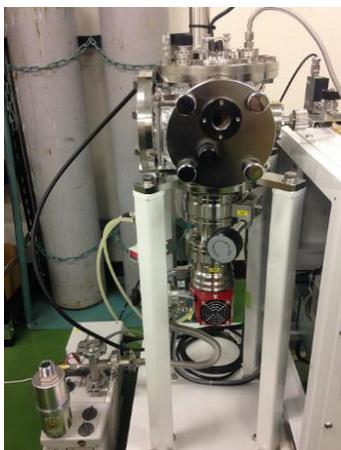
スパッタリングターゲット材を使用されている企業
スパッタリングターゲット材を使用して薄膜技術等を研究している大学等の研究室
スパッタリングターゲット材を取り扱って頂ける商社

連絡先

所属部署	機械加工部		
役職・担当者名	係長 千葉 隼人		
住所	〒981-4263 宮城県加美郡加美町字雁原501番地		
TEL	0229-63-6909	FAX	0229-63-7180
URL	http://www.wide-techno.co.jp/	E-Mail	info@wide-techno.co.jp



スパッタリングターゲット(ミラー面仕様)



小型スパッタ装置

<DC小型スパッタ装置 仕様>
真空チャンバ
内寸 : $\phi 135 \times 180\text{mm}$
真空ポンプ : ターボポンプ
真空度 : $9 \times 10^{-3}\text{Pa}$ 以下
(実質到達圧 10^{-5}Pa 台以下)
カソード(ターゲットサイズ :
 $\phi 32 \times t 1 \sim 3\text{mm}$)